

陶瓷电容器



KR3 系列 **RoHS** **REACH** **啸叫对策** **弯曲裂纹** **焊接裂纹**

民用设备 & 工业设备用高实效容量 · 高纹波耐性带金属端子多层陶瓷电容器

适用用途

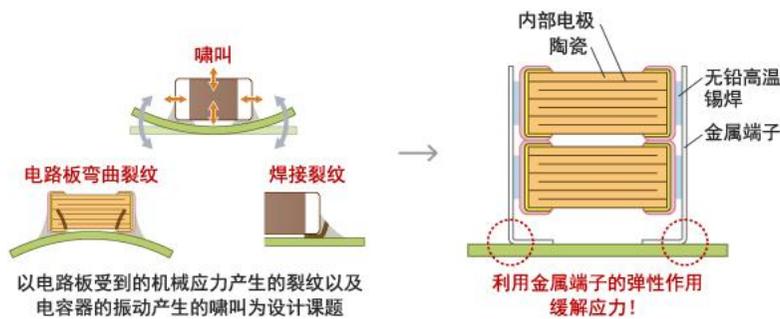
- 民用设备
- 汽车信息娱乐/舒适设备
- 医疗设备[GHTF A/B]
- 医疗设备[GHTF D]
- 植入式医疗器械设备或医疗器械设备[GHTF D]
- 移动设备
- 运输、重工、商用能源相关应用除外的工业设备
- 适用商品：冲击传感器
- 工业设备
- 汽车动力总成/安全设备
- 医疗设备[GHTF C]
- 植入式以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C]
- 植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C]
- 民用设备-差分传输
- 硬盘

产品特点

1. 在贴片的外部电极上焊接金属端子

针对热和机械冲击具有高可靠性。

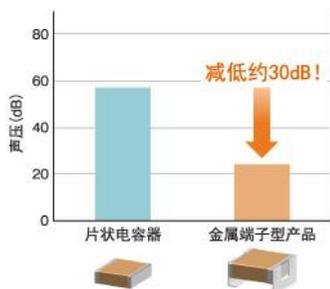
同时大大降低了陶瓷引起的电路板的啸叫。



2. 贴片的堆叠对策

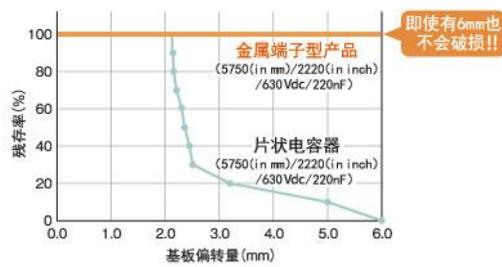
将 2 个电容器进行堆叠，实现大容量化。

● 啸叫减低效果的比较



评价项目：5750 (in mm) / 2220 (in inch) 尺寸 / 630Vdc / 220nF
 测试方法：50Vdc上叠加10Vp-p 3kHz正弦波
 测试基板：环氧玻璃基板(T=1.6mm)
 样本数：3个
 麦克风-基板间距离：5mm
 (注)我公司评价基板的结果

● 基板偏转可减轻应力



● 热应力可抑制焊接裂纹

贴片尺寸	贴片单体 5750 (in mm) / 2220 (in inch) 尺寸	金属端子型产品 5750 (in mm) / 2220 (in inch) 尺寸
1000次循环	焊接裂纹	
2000次循环	焊接裂纹	

测试条件：-55 ~ +125°C, 5分(液相)
 使用基板：环氧玻璃基板(FR-4)

与贴片单体相比，
焊接裂纹耐性更卓越。

